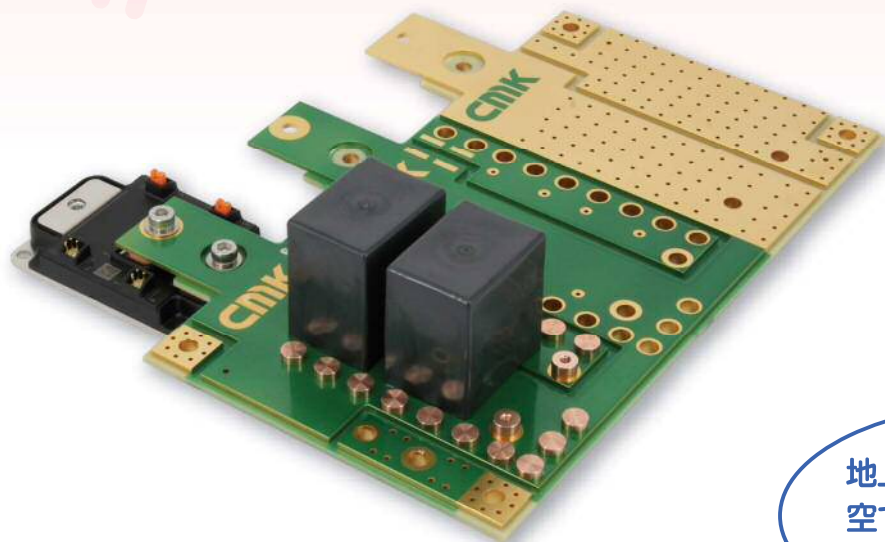


R&D 大電流プリント配線板

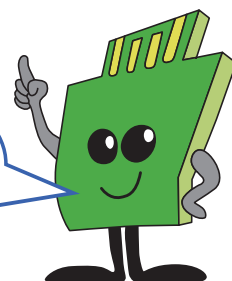
<http://www.cmk-corp.com>

1000A 以上に対応可能

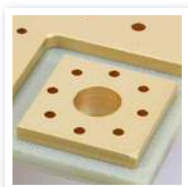


- ・1000A以上の大電流に対応可能
- ・2.0mm以上の厚銅で大電流化を実現
- ・高放熱も可能な構造(銅製スタックピン)

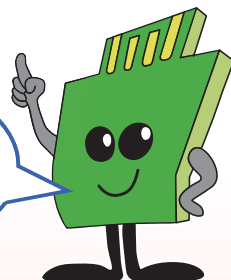
地上ではEV、
空ではドローンタクシーや、
電動プレーンなどに対応



大電流に対応できる厚銅基板を開発



2.0mm 以上の
厚銅で
大電流化を実現



許容電流値算出式

$$I = k \Delta T^{0.44} A^{0.725}$$

I : 電流 (A)

k : 定数 (外層 : 0.048 内層 : 0.024)

ΔT : 温度上昇 (°C)

A : 導体断面積 (mil²)

※ 1 mil = 0.001 inch = 0.0254mm

参考文献

IPC-2221A (Section 6.2 Conductive Material Requirement)

※上記IPC規格は、図(MIL-STD-275E)を参考

	電流 (A)	温度上昇 (°C)	パターン (mm)	導体厚 (mm)	導体断面 (mm ²)
電流値算出	1008.8	20	32	3	37.241

